

Presse-Information

P346/22
6. Oktober 2022

Funktional und trendy – HEIDELBERG setzt bei neuer AMPERFIED Wallboxgeneration auf Gehäusematerial aus Ultramid®

- **Verzugsoptimiertes und witterungsbeständiges, verstärktes Ultramid® gewährleistet hervorragende Konnektivität**
- **Neue Wallboxgeneration startet mit der AMPERFIED Wallbox connect.home von HEIDELBERG**
- **Go!Create: Herausragende Materialexpertise ermöglicht gemeinsame Entwicklung in Rekordzeit**

Enge partnerschaftliche Zusammenarbeit, herausragende Materialexpertise und umfangreiche Möglichkeiten zur Bauteilprüfung des Kunststoffherstellers BASF sind die Basis für die neue Anwendung aus Ultramid® (PA). HEIDELBERG, ein führender Ladetechnologiehersteller, bringt erstmals das Polyamid als spritzgegossenes Gehäuse in der neuen Amperfied Wallbox connect.home zum Einsatz. Diese Weiterentwicklung setzt Maßstäbe in der Wallboxherstellung und ermöglicht als innovative Ladelösung einen großen Schritt in die Zukunft der Elektromobilität.

Ultramid® mit optimiertem Eigenschaftsprofil

HEIDELBERG stellt hohe Qualitätsansprüche an den BASF Kunststoff, um keine Kompromisse bei den Eigenschaften einzugehen. Als zähes und verzugsoptimiertes Material überzeugt Ultramid® in einschlägigen Prüfungen und stellt eine absolut verlässliche Verschraubung mit allen anderen Bauteilen sicher. „Verzugsreduktion erreichen wir mit Hilfe unserer Datenbanken, Produktvielfalt,

Simulation und Erfahrung. So finden wir für unsere Kunden die optimale Lösung“, erklärt Jochen Seubert, Senior Application Engineer für Elektro- und Elektronikanwendungen bei BASF.

In enger Abstimmung und dank Bündelung der Kompetenzen aller Beteiligten – Materiallieferant, Formenbauer und Wallbox-Hersteller – konnten in den BASF Prüflaboren u.a. am Bauteil die geforderte Glühdrahtklasse mit 650°/675° Celsius (maximal zulässige Brandzeit 30 Sekunden) nachgewiesen werden. Bei einer variabel einstellbaren Ladeleistung der Wallbox von 2,1 kW bis 11 kW ist dies unter anderem Voraussetzung für eine entsprechende Zertifizierung.

In weiteren Tests zur Bauteilprüfung stellte sich die gewählte Ultramid®-Type als besonders schlagzäh heraus, was die Amperfiend Wallbox connect.home zu einer robusten und langlebigen Ladelösung macht. Das Material zeigt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung oder Vandalismus, bei gleichzeitig edlem und modernem Look and Touch.

Die Ultramid®-Type erfüllt darüber hinaus die Anforderung in Bezug auf eine einwandfreie elektromagnetische Verträglichkeit. Es besteht keine Gefahr einer Beschädigung der Elektronik aufgrund zu hoher Aufladung des Gehäuses.

Sende- und Empfangswellen können das Gehäusematerial mit ausreichender Stärke durchdringen und ermöglichen die Kommunikation mit der myAMPERFIEND App zur cleveren Steuerung und Diagnose der Wallbox. Auch diese Anforderungen an die Konnektivität der Wallbox waren entscheidend für die Wahl des Kunststoffes.

Einsatz von Kunststoff erhöht Funktionalität

Der Einsatz von Kunststoff im Gehäuseteil vereinfacht zudem die Herstellung der kompletten Wallbox in hohem Maße. Wo zuvor Metall aufwändig gebogen und zugeschnitten werden musste, bündelt das Gehäuse aus Ultramid® all dies in einem Arbeitsschritt während des Spritzgusses. Auch der Lackierschritt entfällt, da das Material mit seiner ansprechenden Oberflächengestaltung direkt verwendet werden kann - weniger Komplexität bei gleicher Wertigkeit und höherer Funktionalität. „Heutige Ultramid®-Typen bieten hinsichtlich Mechanik, elektrischer

Isolation, Optik und Verarbeitbarkeit die optimale Lösung als Gehäusewerkstoff und werden daher gerne von unseren Kunden eingesetzt“, betont Jochen Seubert, BASF, die Vielfalt dieser Werkstoffgruppe.

Go!Create: Eine starke Partnerschaft

Maßgeblich für die Entwicklungszeit von weniger als 1,5 Jahren - von der ersten Materialvorstellung bis zur Marktreife - waren die offene und vertrauensvolle Umgangs- und Gesprächsweise beider Entwicklungspartner von Beginn an. In enger Abstimmung konnten Materialanpassungen und Tests durchgeführt und das Projekt in flottem Tempo vorangetrieben werden. „HEIDELBERG AMPERFIED Wallboxen zeichnen sich schon immer durch ein zeitlos designtes und robustes Gehäuse aus. Mit dem Gehäuse aus Ultramid® haben wir es gemeinsam mit BASF geschafft, die Qualitäten der ersten Generation auf die Wallboxen unserer neuen Generation zu übertragen und zusätzliche Anforderungen, wie beispielsweise an die Konnektivität, hervorragend zu erfüllen“, erklärt Ulrich Grimm, technischer Geschäftsführer der Amperfied GmbH.

Hinweis:

Creator Talk auf der K 2022

19. Oktober 2022, 11 Uhr

“Housing made of Ultramid® in the Amperfied Wallbox connect.home”

Referenten:

Alexander Scheu, Heidelberger Druckmaschinen AG

Jochen Seubert, BASF SE

BASF auf der K 2022: Willkommen auf unserer Plastics Journey!

Go!Create! Auf der K 2022 laden wir alle ein, sich unserer Plastics Journey anzuschließen! An unserem Stand in Halle 5, C21/D21, erkunden wir neue Wege, den Lebenszyklus von Kunststoffen in allen Phasen nachhaltiger zu gestalten: von einer ressourcenbewussten Produktion über eine bessere Nutzung bis hin zu neuen Lösungen, um am Lebensende von Kunststoffen den Kreislauf zu schließen. Wir alle sind auf einer gemeinsamen Reise, um die Herausforderungen rund um Kunststoffe zu lösen. Auf der K 2022 wollen wir diese Reise beschleunigen. Die K ist die weltweit

führende Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk. Sie findet vom 19. bis 26. Oktober 2022 in Düsseldorf statt. Besuchen Sie www.plastics.basf.com/K2022.

Über BASF

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

Über die Amperfied GmbH

Die Amperfied GmbH mit Sitz in Walldorf ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG). Gegründet im April des Jahres 2022, setzt sie das seit 2014 bestehende Engagement des Mutterkonzerns in der Elektromobilität unter neuem Namen fort. Mit umfassendem Know-how in den Bereichen Leistungselektronik und Software positioniert sich die Amperfied GmbH mit innovativen, kundenorientierten und zukunftsfähigen Ladelösungen für den heimischen Bedarf und öffentlichen Raum. Ziel ist es, sich zum Technologieführer für eine emissionsfreie und lebenswerte Zukunft zu entwickeln und dazu die Mobilität und Energieversorgung aktiv zu gestalten. www.amperfied.de